

证券代码：300223

证券简称：北京君正

## 北京君正集成电路股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20250515

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	HCEP Management Limited: Edward Cao; Citadel Advisors Europe Limited: Zhiyi Zhou; Ai-Squared Management Limited: Yu Ji; Hel Ved Capital Management Limited: Daniel Guo 等。
时间	2025年5月15日
方式	现场交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、存储芯片在国内的销售占比？</p> <p>存储芯片在国内的占比在逐渐增长，从之前 20%多到目前 30%左右，国内的汽车市场增长比较好。</p> <p>2、公司车规存储芯片目前的竞争格局情况？</p> <p>目前主要的友商是美光，其产品线也是最全的，不过美光更多聚焦在 LPDDR4 和 DDR5 这类高端产品上，我们从 DDR 到 LPDDR4 都有，目前销售占比最大的是 DDR3，所以和美光是有差异化竞争的。目前我们在做新工艺产品的研发，今年 20nm、18nm、16nm 的产品陆续会给客户提供样品。</p> <p>3、ISSI 目前的管理模式？</p>

	<p>公司收购 ISSI 后, ISSI 一直独立运营, 和我们其他子公司一样, 不过现在人员有一些变动, 原来的 CEO 和 CFO 今年退休, 由公司派新的管理人员任职。CFO 由公司财务总监叶飞兼任, CEO 由公司总经理刘强兼任。</p> <p><b>4、3D DRAM 的总体情况?</b></p> <p>3D DRAM 目前需求升温, 主要是由于 HBM 存在对中国限制的风险, 而 3D DRAM 通过混合键合方式能更好地提供带宽和功耗支持。目前工业界都在尝试这一方向, 而大算力芯片方面, 大型互联网公司在积极尝试, 包括 AI PC、手机端和 AIoT 端也有类似尝试。关于 3D DRAM 的具体搭配方式, 我们会根据市场需求和技术发展进行优化。</p> <p><b>5、公司现在研发团队的布局是怎么样的?</b></p> <p>我们现在的研发团队在全球多地有布局, 包括美国、以色列、日本和韩国等国外地区, 以及国内的北京、上海、合肥、武汉和厦门等地。</p> <p><b>6、车规市场的产品导入需要多长时间?</b></p> <p>车规产品导入需要 1-2 年的时间, 这个与车厂和 Tier1 厂商都有关系。</p> <p><b>7、公司在 RISC-V 上的研发布局情况?</b></p> <p>公司从 2014 年 8 月就开始布局 RISC-V 的研发, 目前有 4 款内核在推进和应用中。</p> <p><b>8、公司芯片产品的价格会做调整吗?</b></p> <p>目前公司芯片产品的价格基本稳定, 计算芯片是消费市场, 竞争比较激烈, 价格波动可能会比较大; 存储芯片是行业市场, 价格基本稳定; 模拟芯片目前国内友商较多, 竞争会比较激烈, 可能也会适当调整价格来获取更多市场。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 15 日